



2026 年 10 月 7 日

各 位

会社名 日 産 化 学 株 式 会 社
代表者名 代表取締役 取締役社長 八 木 晋 介
(コード番号 4021 東証プライム)
問合せ先 経営企画部 企画室長 梁川 真吾
(TEL 03-4463-8123)

子会社の設立に関するお知らせ

当社は、中国に子会社を設立いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、当該子会社の資本金額が、当社の資本金額の 100 分の 10 以上に相当するため、当社の特定子会社に該当することを併せてお知らせいたします。

記

1. 会社設立の目的

当社は、成長が続く中国半導体市場における供給体制の強化を目的として、中華人民共和国江蘇省張家港市に子会社を設立いたしました。

近年、半導体需要の拡大や顧客のサプライチェーン安定化ニーズの高まりを背景に、半導体材料について従来以上に安定した供給体制の構築が求められております。

新会社では、フォトリソスト用反射防止材（BARC）および多層材料の製造・販売を行い、中国国内における供給基盤を強化するとともに、顧客に近接した供給体制を構築することで、需要変動への迅速な対応および顧客サービスの向上を図ってまいります。

これにより、半導体材料事業の持続的な成長と企業価値の向上を目指してまいります。

2. 設立子会社の概要

(1) 商号	日产化学材料 (张家港)有限公司
(2) 所在地	中華人民共和国 江蘇省張家港市
(3) 代表者	中田 孝和
(4) 事業の内容	半導体材料の製造・販売
(5) 登録資本金	2.1 億元（約 50 億円）
(6) 設立年月日	2026 年 9 月 1 日
(7) 決算期	12 月末日
(8) 出資比率	当社 100%

3. 経緯及び今後の予定

当該子会社の設立は、2026 年 4 月 28 日に当社取締役会で決議され、江蘇省張家港市と投資協議書を締結、9 月 1 日に登記されました。今後、2026 年 10 月 15 日に第 1 回の資本金 0.89 億元（約 21 億円）を送金予定です。

4. 業績に与える影響

本件は、2027 年 3 月期業績に与える影響は軽微であると考えております。今後適時開示が必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

以上